第4回

3次元積層 半導体量子イメージセンサ 研究会

KEK　AIST　東京大学　筑波大学

参加費 無料 定員 150 名

2020.1.27 (月) 13:30-17:30

会場：つくば国際会議場（大会議室 102 室）

参加申込

会場準備の都合上、できるだけ事前申込みをお願いします。
詳細はサイトをご覧ください。
http://rd.kek.jp/project/soi/TIA20/2001_TIA3D.html

お問合せ

高エネルギー加速器研究機構(KEK)
先端加速器推進部
倉知郁生 mail: kurachii@post.kek.jp

PROGRAM

招待講演

「SABを使用した
高精度アライメント接合方法及び装置」
ボンドテック(株) 山内　朗

「3次元積層のための表面活性化常温接合」
明星大学 須賀　唯知

「低温接合技術に基づく異種材料集積技術と
センサ・マイクロシステム応用」
産総研 日暮　栄治

一般講演

倉知 郁生（KEK）
藤野　真久（産総研）
原　和彦（筑波大学）

主催：TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」:'3次元積層半導体量子イメージセンサの調査研究'グループ
（高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所、東京大学、、筑波大学）
後援：TIA, TIA 光量子計測マネージメント・グループ 、SOI量子イメージセンサコンソーシアム

かけはし

第４回
3次元積層半導体量子イメージセンサ研究会

program

13：30　**はじめに :TIA かけはし 3D 活動　4 年を振り返って**

高エネルギー加速器研究機構　倉知 郁生

一般講演

13：50　**素粒子実験用 SOFIST ピクセルセンサーの３D 積層**

筑波大学　原 和彦

14：25　**3 次元実装におけるウエハレベルハイブリッドボンディング**

産業技術総合研究所　藤野 真久

招待講演

15：00　**SAB を使用した高精度アライメント接合方法及び装置**

ボンドテック（株）　山内 朗

15：35　**Break**

15：55　**3 次元積層のための表面活性化常温接合**　明星大学　須賀 唯知

16：30　**低温接合技術に基づく異種材料集積技術とセンサ・マイクロシステム応用**

産業技術総合研究所　日暮 栄治

17：05　**ディスカッション**　高エネルギー加速器研究機構　倉知 郁生

17：25　**まとめ**　高エネルギー加速器研究機構　新井 康夫

会場

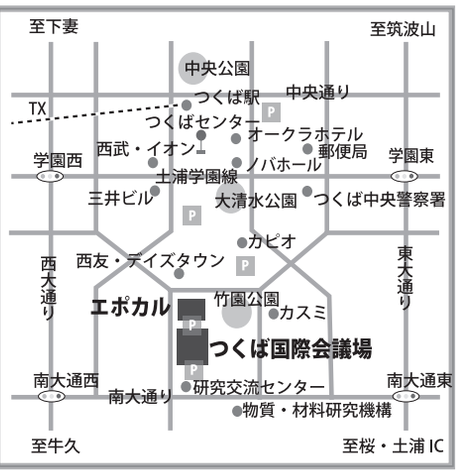
つくば国際会議場（エポカルつくば）

〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3

URL : http://www.epochal.or.jp/

アクセス

つくばエクスプレス　つくば駅より徒歩 10 分

会場周辺に有料駐車場あり

http://www.epochal.or.jp/access/index.html